

Investor  
Relations  
2024

 GAONCHIPS

*Your Partner in Semiconductor Innovation*

 GAONCHIPS

  
GAONCHIPS

NOV. 2024  
Investor Relations

## Disclaimer

---

본 자료는 (주)가온칩스 (이하 '회사')와 관련하여 기관투자자들을 대상으로 실시하는 Presentation에서의 정보제공을 목적으로 작성되었으며  
이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료의 열람은 위의 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에  
대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 또한, 본 자료의 활용으로 인해 발생하거나 발생할 수 있는 모든 손실에 대하여  
'회사' 및 '회사'의 임직원과 주주, 자문역 및 기타 이해관계인들은 과실 및 기타의 모든 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을  
알려드립니다.

본 자료에 포함된 '예측 정보'는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 일체의 사항을  
포함하는 것 (별도 '예측 정보'임을 표기하지 않았다 하더라도)으로 '회사' 및 산업의 향후 예상되는 변화 및 재무의 예상 실적을 의미하는  
것입니다. 동 '예측 정보'는 많은 변수에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 가지고 있으므로 실제 미래에 나타나는 결과는  
'예측 정보'에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

본 자료는 어떠한 주식의 매입 또는 매도 등 매매의 권유를 구성하지 아니하며, 본 자료의 그 어느 부분도 어떠한 계약 및 약정 또는 투자  
결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다. 또한 본 자료는 어떠한 경우에도 민형사상의 분쟁 및 다툼에 있어서 증거자료로 사용될 수  
없음을 알려드립니다.

주식 매입 또는 매도 등 매매와 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융감독원 전자공시시스템을 통해 제출한 신고서를 통해 제공되는  
정보만을 바탕으로 내려져야 합니다.

## The Most Trusted Design Solution Partner

Empowering Your Success, All-round Best Track Record

SAMSUNG Foundry Project Tape-outs

Over **235**



Technology Experiences

Up to **2nm**



Revenue from AI/HPC & Automotive

Over **80%**



Number of Employees

Over **260**



2020 to 2024 CAGR

Over **50%**

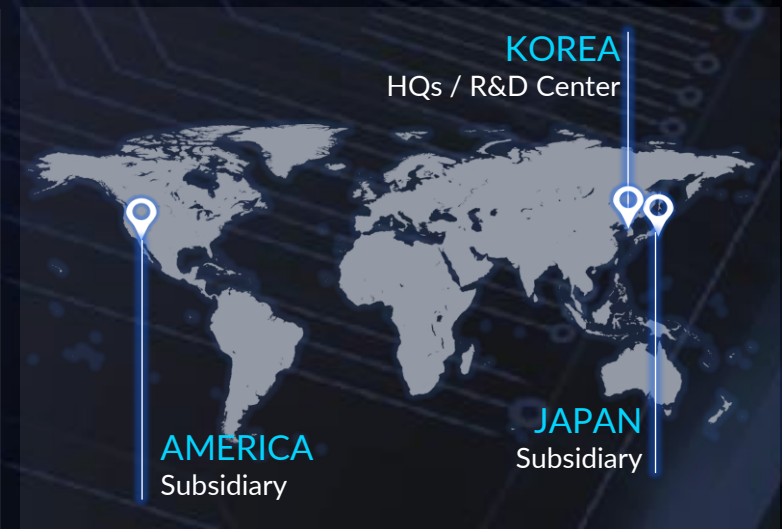
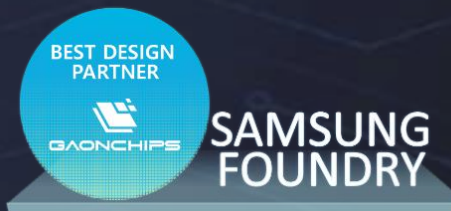
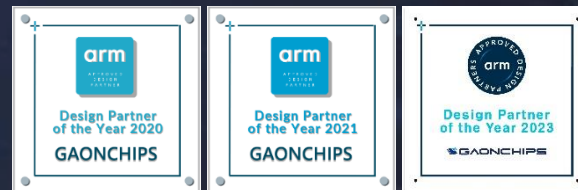


Revenue from ≤14nm Advance node

Over **90%**

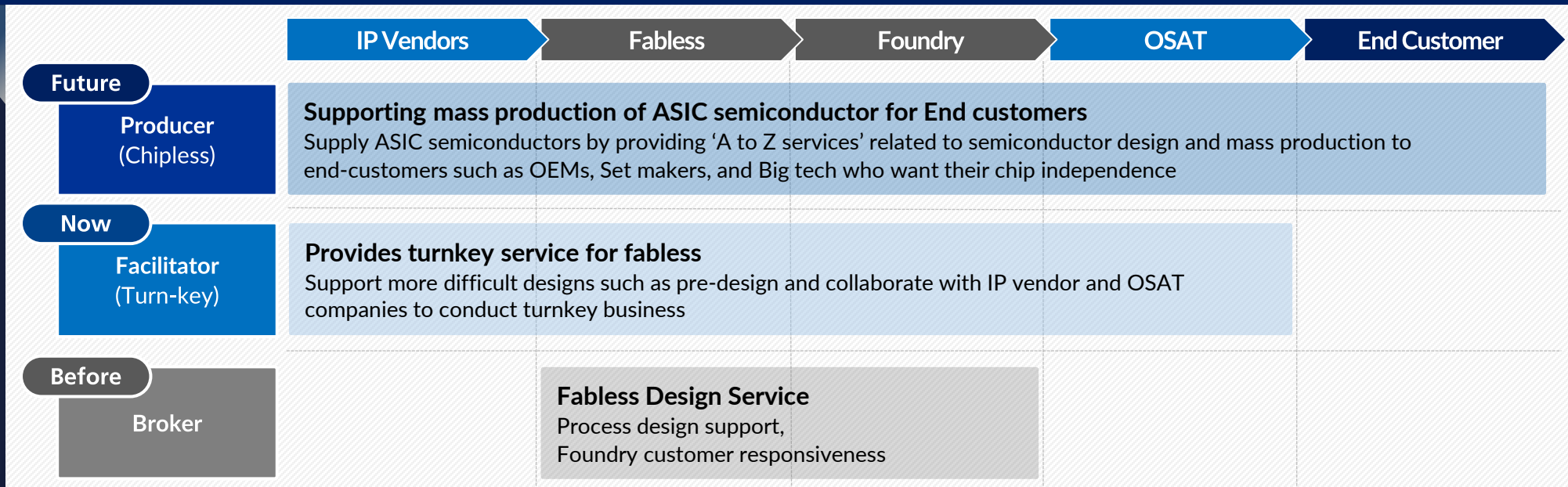


- 2024 Arm Design Partner of the Year 2023  
SYNOPTIS IP OEM Partner
- 2022 Arm Design Partner of the Year 2021  
IPO (Listed on the KOSDAQ)
- 2021 Arm Design Partner of the Year 2020
- 2020 AADP (Arm Approved Design Partner)
- 2019 SAMSUNG FOUNDRY Best Design Partner  
SAMSUNG FOUNDRY Design Solution Partner
- 2018 SAMSUNG FOUNDRY MPW Partner
- 2017 SAMSUNG FOUNDRY Channel Partner
- 2014 SAMSUNG Electronics ASIC Design Service Partner
- 2012 GAONCHIPS Co., Ltd. Founded

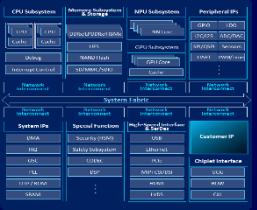
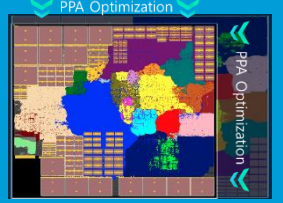
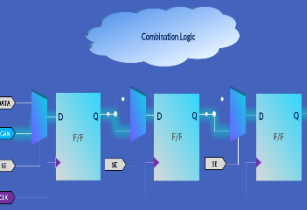
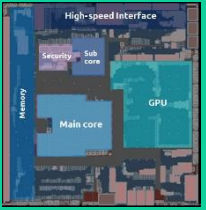
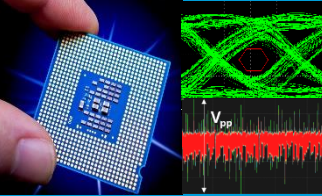



## Design solution company supports design and entire process of before and after production

“ The design solution company has emerged as a 'hub' leading the joint growth of Fabless, Foundry, and OSAT ”



## Tailor-made Full Turnkey Solution From Design Planning to Mass Production

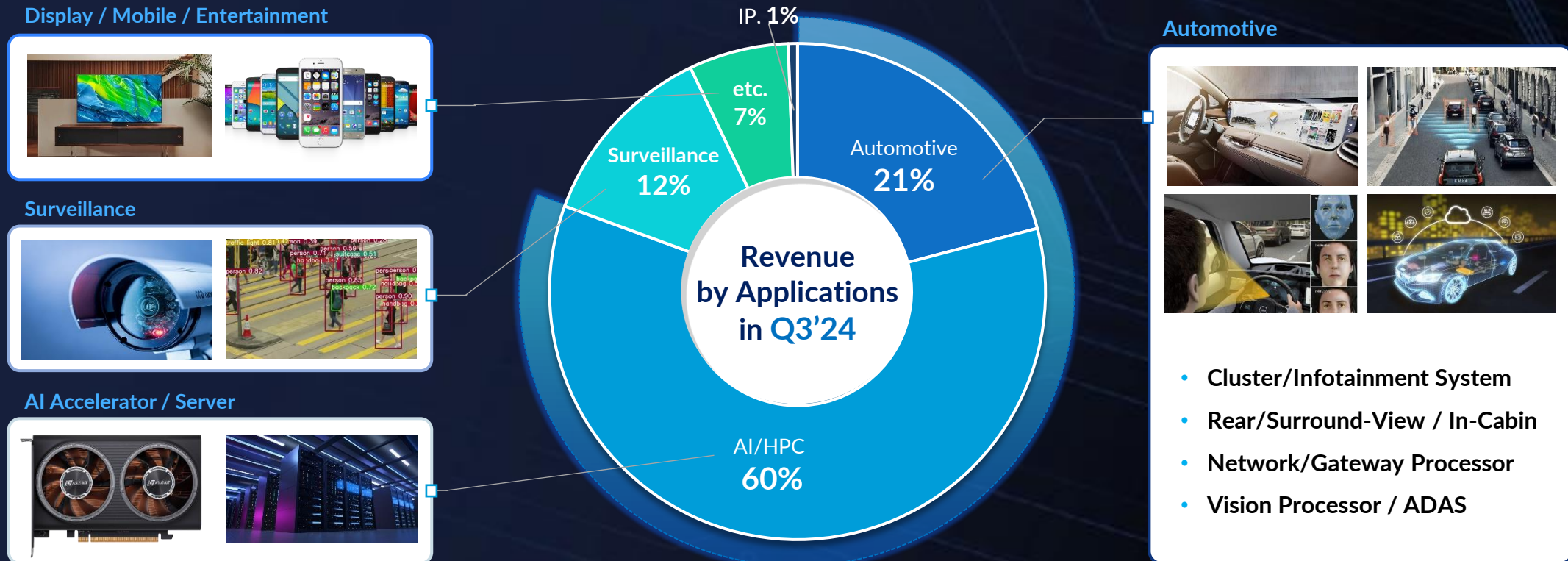
FULL CHIP DESIGN	xPU HARDENING	PHYSICAL IMPLEMENTATION	PHYSICAL DESIGN	PKG & TEST DEVELOP	PRODUCT MANUFACTURING
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Design / Verification Platform</li> <li>• System Architecture Design</li> <li>• Functional Safety</li> <li>• FPGA Prototyping</li> <li>• Device Driver, BSP, OS porting</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP Supplier Partnership</li> <li>• PPA Optimization (Power/Area/Performance)</li> <li>• Floorplan &amp; Layout (Hard Macro IP, SRAM)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• DFT (SCAN/BIST/JTAG)</li> <li>• In-system Test</li> <li>• STA (Static Timing Analysis)</li> <li>• Synthesis &amp; Timing Closure</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Full Chip Floor Plan</li> <li>• Hierarchical Physical Layout</li> <li>• Low Power Design</li> <li>• SI Check (IR Drop, Crosstalk-Noise)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Package Design Guide</li> <li>• Off-chip PSI Simulation</li> <li>• Test vector generation</li> <li>• ATE test set-up</li> <li>• Qualification &amp; Reliability</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wafer Business</li> <li>• Full Turn-key Business (Wafer + PKG + TEST)</li> <li>• QA &amp; Failure analysis</li> </ul>



	SoC Design	Synthesis	DFT Service	Placement & Routing	Physical Verification	Test /PKG	SCM (MP)
Level 0 - Spec. Hand-off	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Level 1 - RTL Hand-off		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Level 2 - Netlist Hand-off			✓	✓	✓	✓	✓
Level 3 - GDS Hand-off					✓	✓	✓

## High-growth market oriented project portfolio

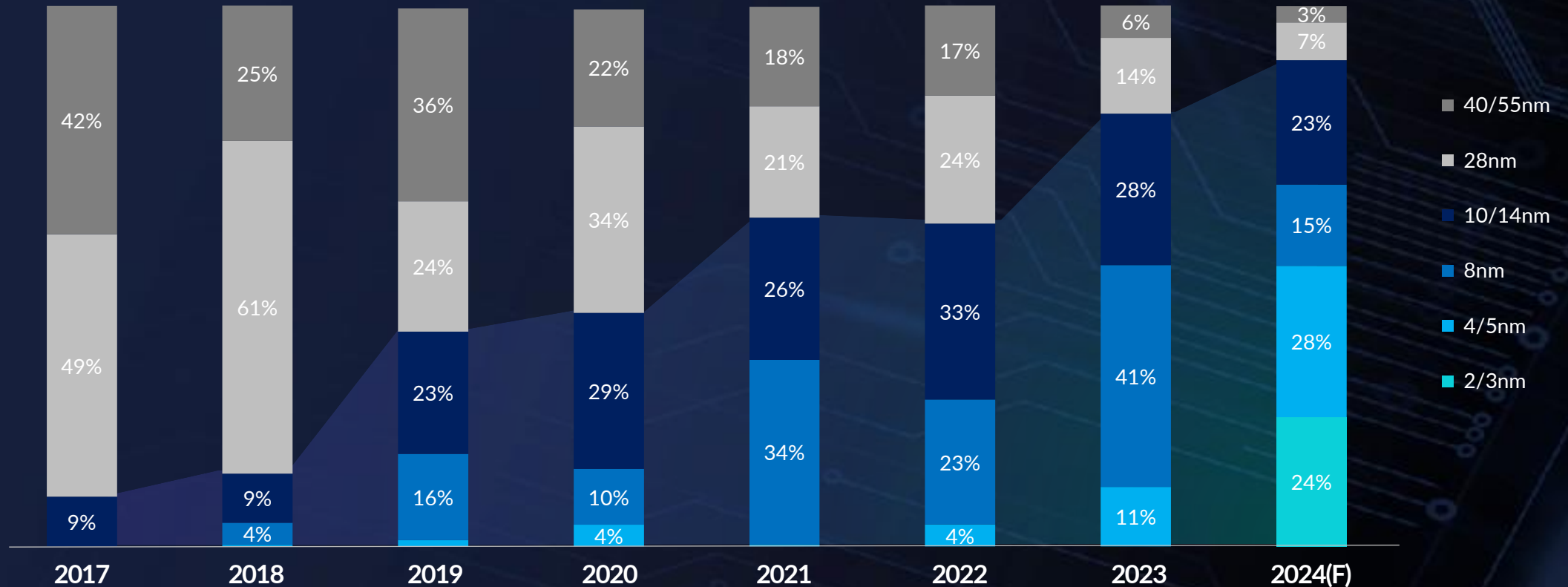
Automotive Heritage with various design experiences and competitiveness  
 (Robust Design, Advanced DFT (Inc. In-system Test), Etc.)  
 Ramp up the AI-enabled HPC market



## Focused on the Advanced Technology Node

Revenue Breakdown by Technology

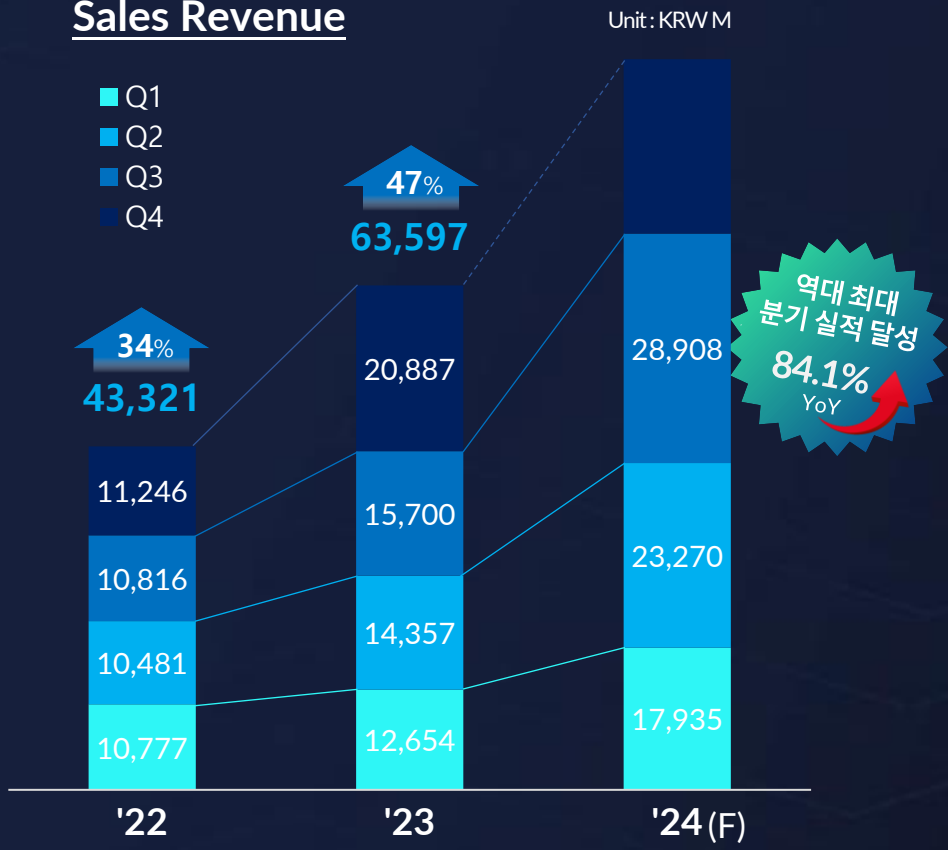
(Unit: %)





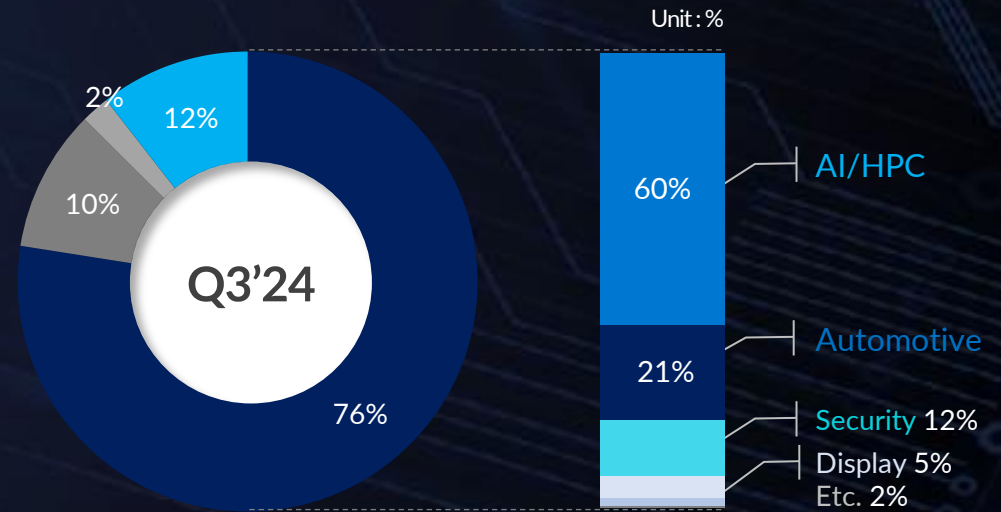


## Sales Revenue



## Sales Portfolio

- Turnkey NRE
- Outsourcing
- Mass Production



### 2024



- 1<sup>st</sup> Overseas Customer Project Win (JPN)
- Arm Design Partner of the Year Award
- US Office Launching (@San Jose)

- 2nm AI Project Design-Win
- SYNOPSIS IP OEM Partnership
- 5nm AI Project Launching for Mass Production

## Quarterly Sales & Profit

Unit: KRW M

■ Sales ■ Profit



(연결기준)	2022년 (제11기)				2023년 (제12기)				2024년 (제13기)		
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기
매출액	10,777	10,481	10,816	11,246	12,654	14,357	15,700	20,887	17,935	23,270	28,908
매출원가	7,802	8,608	7,434	7,848	11,290	11,362	12,078	16,149	16,030	19,912	24,275
매출총이익	2,975	1,873	3,383	3,398	1,364	2,995	3,622	4,737	1,905	3,358	4,633
판매비와 관리비	1,424	2,188	2,436	1,680	2,005	1,528	2,459	2,375	2,514	3,291	2,398
영업이익(손실)	1,552	(315)	946	1,717	(641)	1,467	1,163	2,363	(609)	67	2,236
당기순이익(손실)	1,664	12	755	1,988	40	1,697	1,073	3,535	(402)	1,510	1,649

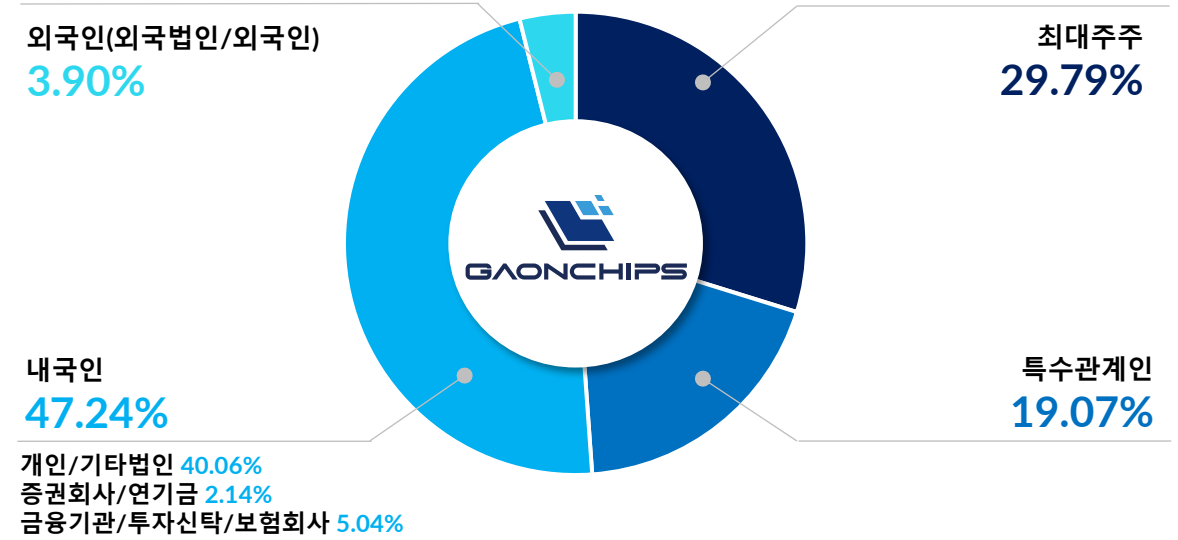
## 회사 현황

회사명	주식회사 가온칩스
대표이사	정규동
설립일	2012년 8월 6일
상장일	2022년 5월 20일
자본금	57억 원
사업분야	반도체 제조업
주요제품	설계 솔루션 및 주문형 반도체
사업장	경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26, N-4F
홈페이지	www.gaonchips.com

## 지배 구조

(주)가온칩스	100%	GAONCHIPS JAPAN Co., Ltd.
		GAONCHIPS AMERICA Inc.

## 주주 구성



## 요약 재무상태표 (연결)

(단위: 억원/%)

과 목	3Q'23	2Q'24	3Q'24	QoQ	YoY
<b>자산총계</b>	852	998	1,034	3.56%	21.31%
유동자산	579	661	679	2.72%	17.27%
현금성자산	22	69	127	83.43%	462.73%
비유동자산	273	337	355	5.21%	29.87%
유형자산	133	175	186	6.39%	39.93%
<b>부채총계</b>	278	364	381	4.85%	37.29%
유동부채	192	291	308	5.74%	60.69%
비유동부채	86	72	73	1.24%	-14.79%
장기차입금	40	41	42	0.82%	3.27%
<b>자본총계</b>	574	634	653	2.83%	13.58%
자본금	57	57	57	0.00%	0.00%
기타자본	281	295	297	0.49%	5.37%
이익잉여금	236	282	299	5.84%	26.66%

## 요약 손익계산서 (연결)

(단위: 억원/%)

과 목	3Q'23	2Q'24	3Q'24	QoQ	YoY
<b>매출액</b>	427	412	701	70.16%	64.16%
매출원가	347	359	602	67.54%	73.39%
<b>매출총이익</b>	80	53	99	88.05%	24.00%
판매관리비	60	58	82	41.31%	36.91%
<b>영업이익</b>	20	-5	17	412.17%	-14.88%
(%)	4.66%	-1.32%	2.41%	0.00%	0.00%
<b>EBITDA</b>	60	35	72	106.61%	19.72%
(%)	14.03%	8.43%	10.23%	0.00%	0.00%
영업외손익	9	10	8	-15.99%	-3.58%
법인세차감전 순이익	28	4	25	472.06%	-11.48%
<b>당기순이익</b>	28	11	28	148.83%	-1.88%

*“Your first and last design partner”*



**GAONCHIPS**

**Contact Us**

[www.GAONCHIPS.com](http://www.GAONCHIPS.com)

**HQ**

Semiplex Tower N-4F, 26, Geumto-ro 40beon-gil, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea (Zip code:13453)  
Tel +82-31-697-8267 Fax +82-31-702-7023 e-mail [gaon\\_sales@gaonchips.com](mailto:gaon_sales@gaonchips.com)

**US Office**

3003 North First Street #302, San Jose, California 95134  
e-mail [gaon\\_us@gaonchips.com](mailto:gaon_us@gaonchips.com)

**JAPAN Office**

1603, Mita Kokusai Building, 1-4-28 Mita, Minato-ku, Tokyo  
Tel +81-03-4500-8667 e-mail [gaon\\_japan@gaonchips.com](mailto:gaon_japan@gaonchips.com)